



Do More.



LiquidJet™ Coldplate

与芯片同速进化的散热冷板

LiquidJet™ 冷板

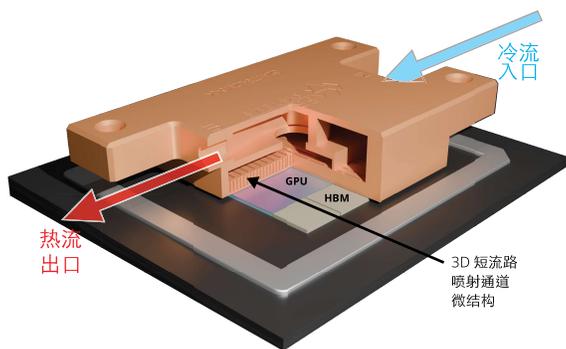
一款与芯片同步进化的散热冷板

产品描述：

LiquidJet 冷板采用独特的多级冷却架构、3D 混合单元以及创新的 3D 短回路射流通道 (short-loop jetchannel) 微结构，可根据任何 GPU 功率分布进行定制化设计。LiquidJet 的创新多级架构使传热效率提升了 75%。它能引导整体流向，将全部流体优先集中冷却热点区域，随后再冷却 GPU 芯片、高带宽内存 (HBM) 及片上系统 (SoC) 中的其他芯粒进行冷却。LiquidJet 可支持在 40°C 进水温度下高达 600 W/cm² 的热点冷却，其性能完全满足未来 GPU (如 Rubin Ultra、Feynman、MI455、MI500 及定制超大规模专用集成电路 ASIC) 的散热需求。

3D 微结构核心：

Fore Systems 采用独特工艺制造 LiquidJet 冷板，将半导体工艺制程应用于金属晶圆，构建多级冷却架构。并创新设计了与数据中心 GPU 功率分布精准匹配的 3D 混合单元结构，与短回路射流通道，能针对数据中心 GPU 的功率图进行精确设计。

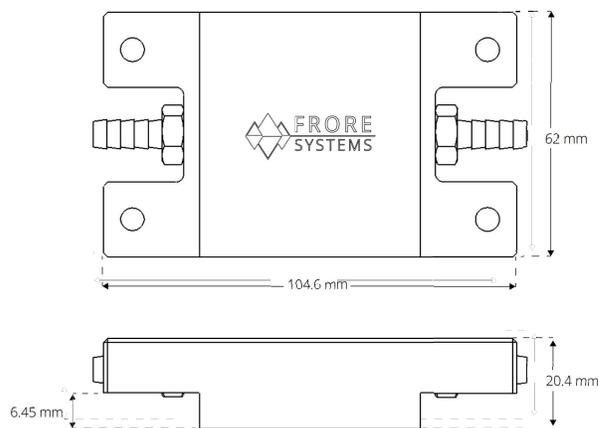


核心产品特性：

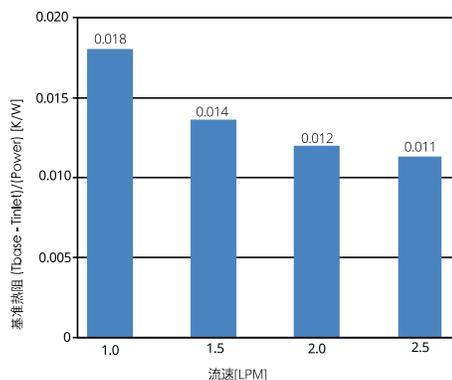
- GPU 温度降低 8°C
- 减重 50%
- 每秒 AI Tokens 生成速度提升 4%
- 电源使用率 (PUE) 降低 10%
- 降低数据中心总拥有成本 (TOC)
- 无缝兼容式升级 (无需改造现有系统)

技术规格：

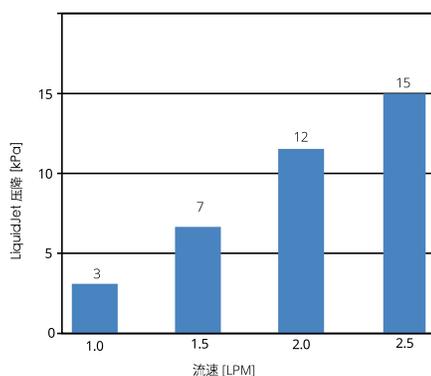
LiquidJet 根据目标 GPU 量身定制。
根据 NVIDIA B300 的实测数据：
长度: 104.6 mm 宽度: 62 mm
高度: 20.4 mm 重量: 260 g
材料: 铜、铜复合材料



LIQUIDJET 热阻



LIQUIDJET 压降



扫描以获取
更多信息